

2018.7.6

スマートエンジニアリング TOKYO 2018 出展のお知らせ

日揮グループとして「スマートエンジニアリング TOKYO 2018」に出展いたします。
皆様のご来場を心よりお待ちしております。

- 会 期：2018年7月18日(水)～7月20日(金) 10:00～17:00
- 会 場：東京ビッグサイト
- 出展小間：東2ホール 2G-31
- 展示内容：
 - ・最新プラント設計手法「P×BIM（JGC Way of Plant & Building Information Modeling）」
 - ・日揮グループのスマート保全サービス「INTEGNANCE」
 - ・日揮ユニバーサルの「カスタム触媒」「新素材」

展示会公式ホームページ

<https://www.jma.or.jp/set/>

来場者事前登録

<https://jmacv.herokuapp.com/smart2018/visitors/confirmmail>

以上